

中信证券股份有限公司

关于贵州振华风光半导体股份有限公司

2023 年半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“振华风光”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责振华风光上市后的持续督导工作，并出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与振华风光签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解振华风光业务情况，对振华风光开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年上半年度，振华风光在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年上半年度，振华风光在持续督导期间未发生违法或违背承诺事项

序号	工作内容	实施情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2023 年上半年度，保荐机构督导振华风光及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促振华风光依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对振华风光的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，振华风光的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促振华风光严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对振华风光的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023 年上半年度，振华风光及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2023 年上半年度，振华风光及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况

序号	工作内容	实施情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2023 年上半年度，经保荐机构核查，振华风光不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年上半年度，振华风光未发生相关情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查；（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2023 年上半年度，振华风光不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司可能存在的相关风险如下：

（一）核心竞争力风险

1、研发未达预期风险

公司围绕市场需求，开展核心技术研发、新产品拓展、技术升级改造等工作，

投入了大量的资金和人力，公司对技术成果的产业化和市场化进程具有一定不确定性，如果在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者研发出的产品未能得到市场认可，公司将面临前期的研发投入无法收回且难以实现预计效益的风险，并将对公司业绩产生不利影响。

2、研发人员不足或流失的风险

集成电路行业是技术密集型行业，关键技术和人才是公司保持持续竞争优势的基础，随着技术研发的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难，这就需要公司在技术研发方面不断加大投入，同时加大对高端、复合型技术人才的引进。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，或者出现研发人员流失的情况，都将会导致公司的竞争力下降。

（二）经营风险

1、客户集中度较高风险

报告期内，由于公司下游客户主要以国有集团的下属单位为主，使得公司以同一集团合并口径的客户集中度相对较高。虽然公司与主要客户形成了密切配合的合作关系，按照特种元器件供应的体系，通常定型产品的供应商不会轻易更换，且公司积极研发满足现有客户需求的新产品、积极拓展新客户、开拓新市场，减少客户集中度高的潜在不利影响。但若公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面进展不利，或现有客户需求大幅下降，则较高的客户集中度将对公司的经营产生影响。

2、税收政策变动的风险

国家一直以来重视集成电路企业的政策支持，公司作为高新技术企业，享受着国家税收政策优惠，但是未来若国家相关税收优惠政策发生变化，将会对公司经营业绩带来不利影响。

（三）财务风险

1、应收账款及应收票据余额较高的风险

报告期内，公司业务规模不断扩大，应收账款及应收票据的余额相应增长。公司主要产品应用于海、陆、空、天、网等核心领域，由于集成电路处于高可靠领域产业链配套末端，配套产品验收程序严格和复杂，结算周期较长，同时受客户主要集中在年末付款且以商业承兑票据结算为主的影响，导致公司销售回款速度慢，应收账款、应收票据规模较大。公司的下游客户主要为央企及其子公司，整体信誉较好，支付能力较强。但若公司不能有效提高应收票据及应收账款管理水平及保证回款进度，将有可能出现应收票据及应收账款持续增加、回款不及时甚至坏账的情形，从而对公司经营成果造成不利影响。

风险管理措施：针对公司业务的特点，公司在签订销售合同时将持续加强对合同签订方经营状况及信用调查，合理制定客户的信用额度；进一步优化应收账款回款激励机制，加大应收账款的催收力度，并严格按照坏账计提政策计提坏账准备，全力降低应收账款不能回收的风险。

2、存货金额较大及发生减值风险

报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，为满足生产经营需要，公司存货相应增加。受产品种类型号多、验收程序繁琐等因素的影响，公司储备的原材料较大，客户尚未验收的发出商品余额较大，导致存货余额较高。同时，公司积极应对客户的需求，提升生产灵活性，结合市场供需情况及预期客户的需求，对部分产品提前备货。若公司无法准确预测客户需求并管控好存货规模，将增加因存货周转率下降导致计提存货跌价准备的风险。

风险管理措施：一方面公司将坚持采用“以销定产、以产定购”的计划型采购模式，对存货规模进行严格控制，同时加强销售队伍建设，不断完善客户需求分析管理体系，合理备货；另一方面严格按照政策定期计提存货跌价准备，以减少存货跌价风险。

（四）行业风险

面对西方国家对我国经济发展的限制，很大程度阻碍了我国信息化、数字化水平的提升和发展，尤其是集成电路的应用范围极广，涉及到电力电网、汽车电子、以及高可靠、高精尖领域，近年来也不断受到针对我国集成电路产业颁布的

一系列禁限措施影响，使得我国集成电路核心水平发展缓慢，芯片制造环节也长期处于“卡脖子”状态。公司作为高新集成电路企业，难免会受到行业波动的影响，若未来国外对我国集成电路行业继续实施限制和封锁，将有可能影响到公司的经营业绩。

四、重大违规事项

2023 年上半年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	647,407,420.09	400,604,088.17	61.61
归属于上市公司股东的净利润	256,553,535.48	166,238,201.29	54.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,359,926.19	165,490,961.89	52.49
经营活动产生的现金流量净额	25,467,706.52	-23,754,934.09	不适用
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,374,625,476.45	4,193,871,940.97	4.31
总资产	5,054,600,416.83	4,816,735,300.18	4.94

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	1.2828	1.1083	15.74
稀释每股收益（元/股）	1.2828	1.1083	15.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.2618	1.1033	14.37
加权平均净资产收益率（%）	5.94	23.67	减少 17.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.84	23.57	减少 17.73 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	11.45	8.22	增加 3.23 个百分点

（三）主要会计数据和财务指标的说明

1、2023 年半年度营业收入同比增长 61.61%，主要系公司积极发挥核心产品竞争优势，大力推进技术创新和新产品布局，实现产品销量增长。

2、2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 54.33%及 52.49%，主要系报告期内营业利润增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增加 4,922.26 万元，主要系年初结转的应收票据同比增加，报告期内收到的票据到期现金流入同比增加。

4、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增长 15.74%、15.74%及 14.37%，主要系报告期内营业收入大幅上升，净利润增加、盈利能力提升所致。

5、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别同比下降 17.73 个百分点和 17.73 个百分点，主要系 2022 年下半年公司上市募集资金到位，公司净资产增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

1、具有较强的技术保障体系

研发方面：公司产业链条完整，具备电路设计、封装设计、测试验证一体化的研发平台，可根据用户需求提供芯片定制设计、封装寄生提取、多维环境仿真等全流程协同设计解决方案，减少各环节技术偏移的研制风险，推动集成电路芯片设计、封装工艺、测试验证三个专业板块的全自主纵深发展。完整的产业链条有助于更高效、灵活的定制化服务，实现研发和市场的高度融合。

晶圆方面：基于商用线的自主高可靠模型库，通过 10 余年来长期合作的商用工艺线流片数据积累，完善了噪声模型、ESD 模型、抗辐照模型、宽温区模型等自主高可靠工艺模型，通过设计修正工艺偏差，解决了商用线工艺控制精度不足，工艺模型缺失等问题，形成了自主的特色工艺模型库，可有效减少重复研发的资源浪费，并为差异化模拟集成电路开发和高可靠器件的需求奠定了工艺基

础。

封装方面：公司具备低空洞真空烧焊、高可靠异质界面同质化等封装关键技术，形成了覆盖第一代直插式封装、第二代表贴式封装和第三代阵列式封装的自动化封装能力，涵盖陶瓷、金属、塑料三大类封装形式 90 多种封装型号，可根据用户需求进行灵活生产。公司近两年启动建设的先进封装产业化项目，已经基本完成建设，新增工艺设备已完成调试，该项目的实施，将进一步提升公司的高可靠集成电路封装技术能力，可满足高密度 FCBGA 为代表的第三代先进封装技术，为公司的系统封装产品提升强有力的保障。同时，该项目的建设也进一步提升了公司高可靠集成电路封装的产能，满足了公司未来几年的供货保障。

测试方面：公司按国家军用标准建立了完善的电性能测试、机械试验、环境试验、失效分析等完整的检测试验体系，公司实验室通过了 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）和 DILAC（中国国防科技工业实验室认可委员会）认证。近年来，通过自主创新突破了超低噪声测试、高速信号测试技术、全温区晶圆测试等关键技术，实现了对微弱信号的精确测试，噪声灵敏度测试可达 nV 级，达到国内先进水平。为了满足未来公司发展的规划，报告期内补充了射频微波、磁编码器等高端新产品的综合测试平台，包括晶圆级、器件级以及系统级的全面完整的测试验证手段，为新产品的扩展奠定了坚实的基础。

2、具有较强的市场竞争优势

公司依托中国振华市场平台，市场配套完整的海、陆、空、天、网服务体系，并形成以用户为中心的“市场-科技-生产-质量”大市场全面服务的文化，截止目前已经在全国设立了 15 个销售网点，驻地销售人员接近 60 人，同时补充建立了片区 FAE 团队，销售网点在具备实时处理订单销售之外，还获得了最快 2 小时内到达现场解决技术问题的响应能力，与此同时，在跟踪新产品需求方面，也起到了超前、快速、精准、范围广的效果。面对形势之变、要求之变，公司打破行业传统的“被动式”营销，打破用户固有的选型习惯，以技术问题为导向，及时对用户需求进行管理识别和分类，努力实现售前、售中、售后的全过程协同式服务。报告期内，公司提供产品及服务的用户已累计至 600 余家，覆盖海、陆、空、天、网等特种领域，具备完善的体系化流程和提供完整的产品解决方案，有灵活的创

新机制和快速的资源整合能力为市场服务，创造行业价值。

3、具有优良的企业文化

公司作为央企控股的国有企业，始终以满足国家装备发展为己任。作为三线企业，始终以奉献国防、为国担当的使命担当，无论面对何种环境和紧迫任务，努力践行拼搏、奉献、担当、务实的企业价值观，圆满完成了多项国家重点任务。

4、开放合作和高效决策

公司一直秉承开放合作的发展理念，和所有供应商一起提升产品质量，提升技术水平，促进双方的文化融合、理念融合，打造区域化资源向一体化资源转型模式，保障供应链的长期稳定优势。针对技术先进、满足产品需求的科技成果，可快速实施成果转化决策，并提供良好的产业孵化平台，通过建立联合实验室、产业联盟、战略伙伴等方式抓住国产化机遇，共同助力行业的成长。

（二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

不适用。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	74,098,880.21	32,949,209.35	124.89
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	74,098,880.21	32,949,209.35	124.89
研发投入总额占营业收入比例（%）	11.45	8.22	增加3.23个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

报告期内，公司持续加大研发投入，研发团队规模进一步扩大，并持续优化研发管理和薪酬激励，支付的人工成本同比增加，同时项目研制进度加快，投入的验证材料、流片费、试验验证费等同比增加。

（二）研发进展

报告期内，公司形成了一种优化电调衰减器中间态驻波的方法及其电路、一种运算放大器输入级电路及输入级差分对电路等新技术专利，共计申请发明专利 12 件、实用新型专利 7 件、软件著作权 1 件、集成电路布图设计 47 件；已授权发明专利 9 件、实用新型专利 7 件、集成电路布图设计 20 件。

报告期内获得的知识产权列表：

类型	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	12	9	79	30
实用新型专利	7	7	91	67
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	1	0	1	0
其他	47	20	161	116
合计	67	36	332	213

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金基本情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 66.99 元。募集资金总额为人民币 3,349,500,000.00 元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 3,259,923,588.89 元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，于 2022 年 8 月 23 日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第 90043 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

2、2023 年半年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计使用 655,254,165.81 元，对闲置募集资金进行现金管理为 740,000,000.00 元，加上募集资金专用账户扣除手续费后累计利息收入净额后，未使用的募集资金余额为 2,634,043,573.29 元。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
2022 年募集资金结余金额	2,628,633,760.81
加：扣除手续费后的利息收入净额等	24,004,928.29
减：募集资金项目的支出	18,595,115.81
减：永久补充流动资金的金额	0.00
截止 2023 年 6 月 30 日未使用的募集资金余额	2,634,043,573.29
其中：闲置募集资金现金管理	740,000,000.00
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	1,894,043,573.29

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

序号	开户银行名称	银行账号	存款方式	余额	募集资金用途
1	中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行	52050152373609000888	活期存款	344,366,916.75	高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目募集资金
2	招商银行股份有限公司贵阳分行营业部	7555916511810502	活期存款	91,656,913.78	研发中心建设项目募集资金
3	中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040021762	活期存款	833,180,585.78	超募资金
4	中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行	2402006429200068732	活期存款	624,839,156.98	超募资金

（二）募集资金使用是否合规

公司 2023 年上半年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规

使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有公司 40.12%的股份。公司实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司，其通过持有中国电子有限公司与中国振华股权间接控制振华风光 40.12%的股份，并通过中电金投间接控制振华风光 2.92%的股份，合计控制振华风光 43.04%的股份。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未直接持有公司股票，通过员工持股平台（风光智、风光芯）、中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票情况如下：

序号	姓名	任职情况	间接持股情况	减持情况	质押或冻结情况
1	张国荣	董事长	持有风光芯 6.04%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 7.64%的份额	无减持	无质押或冻结
2	赵晓辉	董事兼总经理	持有风光智 5.44%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 10.01%的份额	无减持	无质押或冻结
3	刘宗永	党委副书记、纪委书记、总法律顾问、工会主席	持有风光芯 4.83%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 5.18%的份额	无减持	无质押或冻结
4	刘岗岗	副总经理	持有风光芯 4.83%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 5.86%的份额	无减持	无质押或冻结
5	唐拓	副总经理	持有风光智 4.35%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	无减持	无质押或冻结

			参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 5.86%的份额		
6	胡锐	副总经理、董事会秘书、核心技术人员	持有风光智 4.35%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 5.86%的份额	无减持	无质押或冻结
7	王德成 (离任)	副总经理	持有风光智 4.35%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 5.18%的份额	无减持	无质押或冻结
8	刘健	副总经理	持有风光芯 4.83%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 5.58%的份额	无减持	无质押或冻结
9	孟利云 (离任)	总会计师	持有风光智 4.35%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 3.41%的份额	无减持	无质押或冻结
10	李政	核心技术人员	持有风光智 2.31%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 2.54%的份额	无减持	无质押或冻结
11	李平	核心技术人员	持有风光智 1.73%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 2.80%的份额	无减持	无质押或冻结
12	唐毓尚	核心技术人员	持有风光智 3.27%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 2.52%的份额	无减持	无质押或冻结
13	夏良	核心技术人员	持有风光智 1.16%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 2.52%的份额	无减持	无质押或冻结
14	李雪	核心技术人员	持有风光智 1.16%的出资份额，通过中信证券振华风光员工参与科	无减持	无质押或冻结

			科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 2.80% 的份额		
--	--	--	--	--	--

注：截至 2023 年 6 月 30 日，风光智直接持有公司股份 3,869,867 股，风光芯直接持有公司股份 3,486,239 股，中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划直接持有 3,713,333 股。

除上表列示以外，公司其余董事、监事和高级管理人员未直接或间接持有公司股票。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接和间接持有的振华风光股份不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：


马峥


王彬

